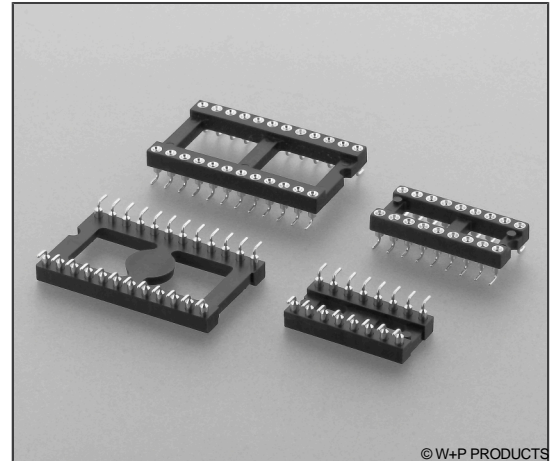


SMT IC-Fassungen RM 2,54mm – Präzisionskontakte in Gull Wing Ausführung SMT IC Sockets 2.54mm Pitch – Gull Wing Screw machined Contacts

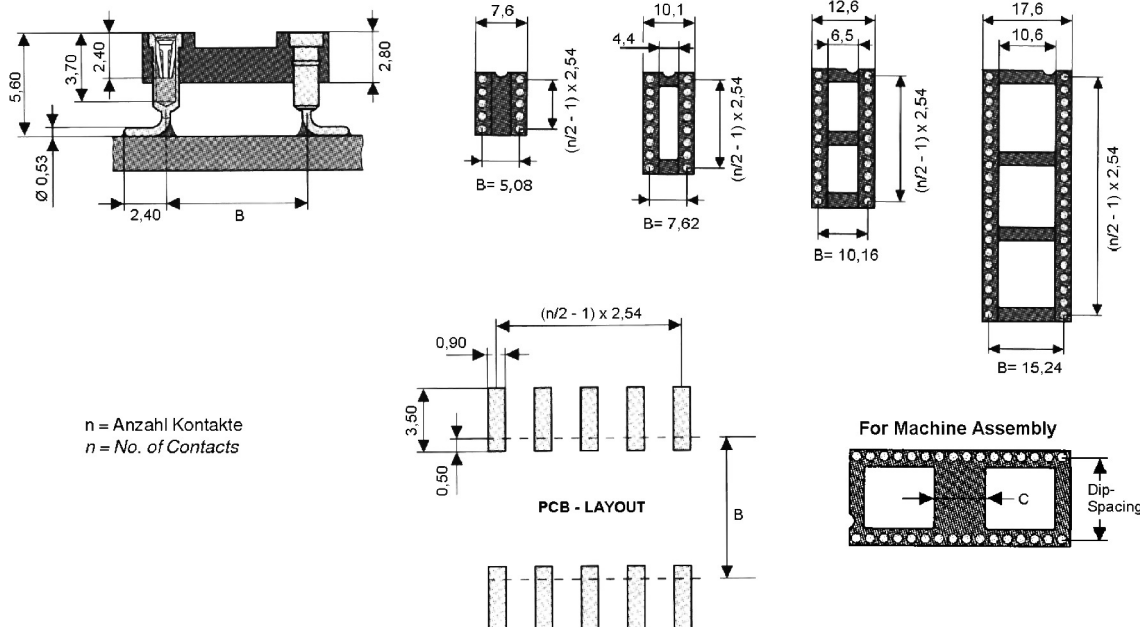
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



Series	Contacts*	DIP Spacing*	Assembly*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Package
3240	28	4	1	50	00	ST
	10 =====> 04/06/08/10/ 14/16/18/20/ 22/24/28	2 5,08mm	1 Handbestückung Manual assembly	50 Verzinkt Tin plated	00 Vergoldet Gold plated	ST Verpackt in Stangen Packed in tubes
	=====> 22/24/28/32	3 7,62mm	2 Automatenbestückung Maß C auf Anfrage Machine assembly		10 0,25µm Gold (Option) 0,25µm gold plated (Option)	
	=====> 24/28/32/36/ 40/42/48	4 10,16mm	Dim C on request		30 0,75µm Gold 0,75µm gold plated	
	=====>	6 15,24mm				

* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

